

2-1-2-13 SR 当て傷 / SR 的碰伤 / Nick on solder resist

【特徴】SR 表面のやや太目の浅い傷

【特征】在 SR 表面有面积较大的, 浅的碰伤。

【Characteristics】Slightly wide and shallow marks on the solder resist surface

【原因・判断ポイント・発生工程】製品やワークボードなどのエッジを無意識に接触させたことにより出来たもの (SR 塗布乾燥後工程)

【原因、判断要点、发生工序】无意识地接触到产品或者在制板边缘等所造成的 (SR 烘干后工序)。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The nick is formed by careless contact of an edge of a product or a panel. (After solder resist coating and curing process)



【コメント】顕微鏡倍率×50

【注釋】显微镜倍率×50

【Comments】Magnification: ×50



【コメント】顕微鏡倍率×70

【注釋】显微镜倍率×70

【Comments】Magnification: ×70

2-1-2-14 SR 引抜擦り傷 / SR 的拉伤 / Scratch on solder resist by board pulling

【特徴】SR 表面の比較的浅い引きずり傷

【特征】在 SR 表面有比较浅的拉伤。

【Characteristics】A relatively shallow scratch on the solder resist surface

【原因・判断ポイント・発生工程】高く積み重ねたボードの中などから無理に引き抜いたことにより出来たもの (SR 塗布乾燥後工程)

【原因、判断要点、发生工序】板件从堆垛中等硬拉出来而引起的 (SR 烘干后工序)。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The scratch is formed by pulling out of a board forcibly from a high stack of boards (After solder resist application process)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×10

【注釋】显微镜倍率×10

【Comments】Magnification: ×10